

重庆人文科技学院
光纤微加工与传感实验室项目
竞争性谈判文件

重庆人文科技学院制
2026年6月12日

第一部分 竞争性谈判项目书

一、项目名称及编号：

光纤微加工与传感实验室项目 编号：2026068

二、资格要求：

1. 须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审，**经营范围包含仪器仪表销售或设备生产厂家**。
2. 拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。
3. 具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系。
4. 确保能够提供符合要求的合格产品，具有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。
5. 近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

三、产品质量及服务要求：

1. 所有产品必须符合国家相关法律法规要求。
2. 保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。
3. 供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。
4. 竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。
5. 竞谈文件一式肆份，壹正叁副。

四、设备名称、数量及参数要求：

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 参考参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
|----|-------|-------|--|----|----|-------|-------|----|
| 1 | 磁控溅射仪 | | 实现裸光纤包层圆周镀金、银等金属薄膜，可控镀金膜膜厚40-70nm范围，圆周镀膜膜厚一致性误差不超过3nm。镀成的光纤SPR传感器折射率检测灵敏度不低于3000nm/RIU，SPR共振谷深度不低于0.3a.u。靶材配置：Au金靶材2片，圆形平面靶材，直径 $\geq \Phi 50\text{mm}$ 。样品室结构：复合式密封腔体，金属加固主腔体+高透光防爆玻璃观察腔体，可实时目视观察 | 1 | 套 | | | |

| | | | | | | |
|---|----------|--|---|---|--|--|
| | | 腔内溅射成膜状态。镀膜工艺：直流磁控溅射沉积方式。样品承载平台：一体化匀速旋转样品台 $\geq \phi 70\text{mm}$ ；样品安装高度40~80mm精密可调，可兼容常规平面基片、柱状试样、异形构件等样品。溅射供电系统：低纹波直流溅射电源，功率输出连续线性可调，放电状态平稳，电流电压波动小，薄膜厚度均匀。真空性能指标：腔体极限真空可达1Pa，低气压区间起辉稳定，可满足低气压精细化溅射工艺条件，适配弱起辉工况。溅射电流调节：工作溅射电流0~100mA范围连续可调，可根据不同靶材、工艺要求灵活切换高低功率沉积模式，实时显示电流与真空度的关系。真空检测模块：高精度皮拉尼真空传感组件，实时动态采集腔体内气压参数，数值反馈精准，实现真空状态可视化管控。人机交互配置：配备工业级高清触控显示屏 ≥ 7 寸，界面简洁直观，参数设定、设备操控一键完成，操作简单易上手。控制系统：支持手动精细化参数调节、全自动一键流程镀膜双模式切换，工艺可储存复刻，同时适配柔性、易损类材料温和镀膜工艺。精密气路系统：预留多路独立精密气路接口，支持氩气等保护气体、多种反应气体接入，搭配稳压节流结构，气体流量可控、气压环境稳定，保障反应溅射工艺稳定运行。高压输出性能：设备最高输出耐压可达1600V或以上，低压环境下等离子体激发能力强。真空机组配置：配套高稳定性机械泵真空系统，抽气速率平稳，运行噪音低、耐高温可持续作业。薄膜沉积速率：沉积速率0~60nm/min范围可调，可实现超慢速薄层沉积与常规厚膜快速镀膜，满足精细化超薄膜与功能厚膜制备需求。高精度膜厚在线监测系统：集成一体化高精度膜厚监测模块，膜厚监测量程0~6000nm；支持超低速沉积过程实时捕捉，速率监测分辨率高达0.001nm/s；设备主控系统与膜厚监测单元全程序联动通讯，实时同步厚度数据，可自动修正沉积参数，形成镀膜闭环精准管控，薄膜厚度一致性、实验重复性与成品良品率高。 | | | | |
| 2 | 卤钨灯光源 | 实现对125 μm 裸光纤SPR传感器（包括单模光纤、渐变折射率多模光纤、阶跃折射率多模光纤等常见SPR传感光纤）提供波长范围适配、功率稳定的宽谱光输入。波长范围360-2500nm、电功率5w以上、光纤输出光功率不小于1mW。输出光强连续可调节、SMA 905接口、色温2800K~3400K、寿命不小于8000小时、稳定性小于0.3%/hr。 | 1 | 套 | | |
| 3 | SPR光谱解调仪 | 内置聚焦镜，光谱解调仪显示屏不小于27英寸，光谱解调仪具有能实时显示采集光谱功能，可显示采集的SPR参考光谱、测试光谱，具有将光谱归一化处理功能，具有将归一化后的光谱与参考光谱相减功能。具有解调SPR衰减反射谱功能，并可寻找显示SPR共振谷最低点波长。具有拟合不同测试物质对应的SPR共振谷波长功能。波长范围：需至少覆盖350-1000nm。波长分辨率：不大于0.25nm。积分时间：3.8ms-10s。信噪比：250:1（单次扫描@10ms）。波长稳定性：不大于0.02nm/°C。动态范围：不小于1300:1（单次扫描）。像素：3648或以上。狭缝：25微米/50微米（可外部自 | 1 | 套 | | |

| | | | | | | |
|---|-------|--|---|---|--|--|
| | | 行更换)。光耦合口: SMA 905。软件: 有数据流图窗口, 兼顾吸光度光谱, 透反射光光谱, 颜色测量, 可全波段光谱数据自动高速采集, 也能实时监测单波长处光谱随时间变化, 具有函数选择库, 含常数、初等数学、高等数学、时间序列、源、圆整/限制、颜色处理以及视图, 支持工程自定义设置和工程保存记忆, 支持至少三种不同电脑操作系统; 支持二次开发。具有 SPR 散斑信号采集模块: 相机接口 USB3.0; 分辨率不低于 5496×3672; 像素尺寸: 2.4 μm×2.4 μm; 曝光时间: 12 μs-1s; 镜头接口: C 口; 配套 350-700nm K9 双凸透镜、光学实验转接板、2 个光学支撑调节杆、2 个可调光学透镜套筒、3 轴旋转光学调整架、法兰光纤耦合器。 | | | | |
| 4 | 光纤熔接机 | 具有光纤拉锥以及光纤烧球功能。光纤拉锥直径: 可以把光纤拉锥, 拉锥直径连续可控, 最小直径到 10 μm。光纤烧球: 单根光纤中间烧球, 烧球直径连续可控, 最大直径到 400 μm。内置大容量锂电池, 可完成不少于 500 次接续和加热以及 550 次拉锥和烧球。具有分步熔接和自动熔接功能。光纤类型: SM(单模), MM(多模), DS(色散位移), NZDS(非零色散位移) 等各种石英光纤。接续损耗不大于: 0.02dB(SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(DS), 0.04dB(NZDS)。回波损耗: 大于 60dB。操作方式: 手动、半自动、全自动。光纤对准: PAS 对准。熔接成功率: 一次性熔接成功率≥96%。熔接时间: ≤9s。加热时间: ≤15s。光纤切割长度: 8~16mm。放大倍数: 300/200 倍。图像显示: 640*480 像素 (4:3) 5 英寸液晶屏。张力测试: 标准 2N(可选)。电池寿命: 循环充电次数不少于 300 次, 电池更换简易方便。电极寿命: 不少于 3000 次, 电极更换简易方便。接口: USB, 方便数据下载和软件更新。照明功能: V 槽处有高强度、宽范围照明灯, 方便夜间操作。工作环境: 工作温度: -20℃~+60℃; 存储温度湿度: -20℃~+70℃; 0~95%RH(不结露); 海拔高度: 0~5000m。配备光纤切割刀、交流适配器、携带箱。 | 1 | 套 | | |
| 5 | 光纤切割刀 | 适用光纤类型: 单芯光纤。兼容被覆光纤外径: 0.25 mm (250 μm) 和 0.9 mm (900 μm)。光纤包层直径: 125 μm。切割角度: ≤0.5°。切断长度: 0.25 mm 光纤: 9-16 mm。0.9 mm 光纤: 10-16 mm。刀片寿命: 不低于 36000 次。 | 1 | 套 | | |
| 6 | 倒置显微镜 | 可以良好观察光纤端面 and 微加工结构。附带 532nm 强光纤激光光源, 可实现光纤内传输光束的观测。附带摄像头及配套软件、专业解调装置, 可良好记录光纤端面和侧面光场。摄像头传感器为不低于 1 英寸彩色芯片; 分辨率不低于 4088 × 3072; 至少 1250 万真实物理像素; 像素: 3.1 μm × 3.1 μm; 曝光控制: 覆盖 50 微秒到 10 秒; 有效增益 1X-32X, 光谱响应 380nm-1100nm; 数据接口: USB3.0 高速, 逐行扫描, 连续输出, 电子卷帘快门; 支持 SDK 二次开发; 配套软件参数: 支持实时单点 RGB 值以及灰度值获取, 实时预览帧率显示, 直方图均衡化; 支持实时拼接以及实时景深扩展功能; 支持扩展电动显微镜控制, XY 电动移动以及 Z 轴的电动对焦。 | 1 | 套 | | |

| | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|--|--|
| | | <p>光学系统：模块化无限远光学系统。观察筒：铰链式双目，瞳距调节范围 50mm-70mm。目镜：大视野目镜，平场目镜 WF10×，视场数 23mm。物镜：长工作距离平场消色差物镜 LWDPlan4X/0.1 工作距离：11.98mm，长工作距离半复荧光物镜 Plan Fluor10X/0.3 工作距离：7.1mm，长工作距离半复荧光物镜 Plan Fluor40X/0.65 工作距离：1.6mm，长工作距离平场消色差物镜 Plan10X/0.26PH 工作距离：10.5mm，长工作距离平场消色差物镜 Plan20X/0.45PH 工作距离：5mm。调焦机构：粗微调同轴，配有限位装置和锁紧装置，低手位同轴调焦手轮，微调手轮格值 1 μm。转换器：六孔内定位转换器，滚珠轴承内定位，有防霉装置。载物台：固定式载物台不小于 240mm×240mm；移动范围：不少于 85mm×85mm。透射照明系统：长寿命 LED 光源，寿命 2 万小时以上，亮度可调，LED 旋钮式亮度调节器。聚光镜：工作距离不小于 70mm，数值孔径 N.A.0.3。接口：内置式 1XC 摄像头接口。</p> | | | | |
| 7 | 阿贝折射仪 | <p>测量范围（折射率 nD）：1.3000 ~ 1.7000 测量范围（Brix，锤度）：0 ~ 95% 准确度（折射率 nD）：±0.0003 观察方式：双目 读数方式：机械光学度盘读数 温度显示：数字温度计（支持外接恒温水浴控温） 适用场景：可测液体或固体折射率</p> | 1 | 套 | | |
| 8 | 光纤磨锥机 | <p>支持多种端面 PC、APC、锥形端面及楔形端面的全自动研磨。光纤双楔面研磨时长：小于 5min。电动精密角度控制，精度不高于±0.01°。实时视频监控，集成端面检测功能。支持转速、压力、时间等参数数字化设定。适用光纤类型：单模、多模、保偏、PCF、硫系玻璃、蓝宝石、能量光纤、医疗光纤等。光纤直径范围：60-3000 μm。锥形端面角度范围：10-160°可调。斜面端面角度范围：5-85°可调。角度调节精度：不高于±0.01°。角度调节方式：电动自动调节。上下位移重复精度 <0.005mm。转速范围：30-200rpm（可调）。研磨时间设定：0-180 秒，数字可调。显示器：不小于 24 寸。工艺存储：可存储不少于 1000 组研磨工艺。夹具旋转同心度：0.002-0.003mm。夹持电机旋转同心度：0.01mm。研磨盘跳动幅度：小于 0.005mm。光纤夹具：支持 60-2000 μm 多规格夹具定制。产品配制：研磨主机 1 台；电动高度调节架 1 套；电动角度调节模组 1 套；电动光纤旋转模组 1 套；端面检测模组 1 套；4K 高清摄像机 1 台；工业摄像机 1 台；显示器 2 台；工艺编程系统 1 套；光学平台 1 套；光纤测量软件 1 套；125um、220um、440um 插芯 各 1 个。</p> | 1 | 套 | | |
| 9 | 光纤侧抛机 | <p>5 轴滑台控制光纤研磨，20-180 度可调角度，支持各类 PC、APC 及锥形、楔形光纤研磨。高清视频实时监控研磨，端面外形及过程一目了然，零延迟。内置光纤测量软件，智能测量研磨角度，数据可记录追溯。适用于特种、医疗、能量光纤，及实验室研发。压力范围：0-500n（根据夹具不同可调）。光</p> | 1 | 套 | | |

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|---|--|--|
| | | <p>纤直径：60-3000 μm。研磨转速：0-185 rpm 可调。光纤转速：0-800 rpm 可调。研磨角度范围 斜面（20-180°）锥形（30-180°）。研磨时间（秒）0-180 切换。LCD 显示器尺寸：不小于 10 英寸。监控摄像机：高清 4K 像素。光纤调台行程 X 轴 200 mm Y 轴 100 mm Z 轴 150 mm。支持光纤类型：单模、多模、保偏、PCF、硫系玻璃、蓝宝石及特种光纤。产品配制：研磨主机 1 套、5 轴滑台、光纤摄像机、显示器、光纤夹具、数显千分尺、测量软件、光纤照明灯。配备光斑分析仪：不低于 630 万像素，CMOS，USB3.0 工业相机；像元尺寸 2.4 μm×2.4 μm；动态范围不小于 71dB；信噪比：不小于 40dB；灵敏度：不小于 760mV；暗电流：不大于 0.15mV；增益范围：1-50 倍；曝光时间范围：不小于 20 μs-15sec。</p> | | | | |
| 10 | 光纤传感加工与测试夹持台 | <p>1、光纤激光微加工系统</p> <p>（1）光纤激光微加工机：最大激光功率：不小于 30W；激光波长：10.64 μm；激光重复频率：≤25KHz；加工范围：不小于 100mm×100mm；加工深度：≤3mm；加工速度：≤7000mm/s；最小线宽：0.1mm；最小字符：0.8mm；加工重复精度：±0.05mm。产品配置：激光器不小于 30W；振镜系统：光电振镜 2 个；工控机；显示器：17 寸液晶显示器；软件：专用控制软件；控制卡；工作台：手动工作台。</p> <p>（2）视觉观测要求：CCD 工作站；定位目标：加工光纤；相机分辨率：不低于 5472*3648；像元大小（μm）：2.4；成像精度（mm）：不大于 0.02mm；放大倍率：0.6x；单次拍照+处理时间：不大于 300ms+150ms（ms）。</p> <p>2、光纤微加工系统夹持装置：</p> <p>（1）可实现将光纤水平固定在光纤激光加工系统焦距位置，可实时观测光纤端面和光纤加工区域形貌。夹持装备自身可在 X、Y 方向上连续调整位置，适配加工位置的更改。</p> <p>（2）多轴精密手动位移台：左右对称配置各 1 套，固定于位移台底面板上，整体高度适配标准光学平台光路系统，即台面与中心应力装置光学同高。平动轴 X/Y/Z：单轴行程≥±6.5mm，微调精度≥10 μm/刻度；旋转轴 θz（绕轴旋转）：360° 全范围连续可调，精调范围为±10°。单台负载需≥3kg，台面需预留标准 M6、M4 通用安装孔位，可适配安装光纤夹具。</p> <p>（3）位移台底板：刚性连接多轴位移台，使其在同一水平面，底板下方配套可调节位移机构，X、Y 位移行程±30mm，负载≥5kg，最小读数 0.1mm，底板长度须适配激光微加工系统台面。</p> <p>（4）光纤夹具模块：需 360° 轴向连续可调，旋转轴面有刻度标识，刻度精度小于等于 5° /刻度。夹具须配有 125 μm 包层直径的裸光纤夹具，保证夹具夹紧光纤后，在激光微加工过程中，光纤无滑移、无偏移、无低频晃动，保证激光微加工光纤的精准性。</p> <p>（5）光纤成像模块：光纤夹持装置正前方、侧方需各配 1 套高像素采集相机（带显微物镜），400 万像素，2 μm×2 μm 像素单元，2688×1512 分辨率，支持图像输出显示、USB 输出、HDMI 高清输出（HDMT 输出 1080P；USB 输出 30@fps），可连接鼠标进行</p> | 1 | 套 | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>图像标注和测量，且可支持 U 盘连接进行图像保存。成像支持 1X-16X 变焦放大，配合物镜最大可放大 200 倍，支持自动/手动自平衡，对比度清晰度饱和度 10 倍可调节，配套成像显示模块。</p> <p>(6) 成像模块底座：配套对应成像系统夹持器，CCD 高度上下可调 ±10mm，底座配套 X、Y 位移机构，XY 行程 ≥ ±25mm，底板开 M6 孔位，使其可固定在光学平台上。</p> <p>3、光纤应变温度传感器性能测试装置：</p> <p>(1) 可实现为待测试光纤传感器样品施加可控的高精度轴向应变，施加的应变精度不高于 2.5 微应变。光纤传感器两端施加的应变需独立可控，应力施加过程需电控完成。可实现为待测光纤传感器提供宽温域高精度可控温度场，支持室温至 400℃ 的宽范围调控，且温度调节控制精度 ≤ 0.1℃。支持应变与温度双参数的联动控制与同步测试，可精准完成光纤传感器的应变灵敏度、温度灵敏度标定。</p> <p>(2) 高精度电动位移机构：左右两侧均需配备高精度闭环控制直线位移台，支持同步反向/同向运动，可自定义单台独立控制或双台联动控制模式。驱动核心采用精密滚珠丝杠传动结构，配套闭环伺服电机，单轴行程 ≥ 50mm，双台联动总拉伸行程 ≥ 100mm。闭环运动控制精度（全行程内）：定位分辨率 ≤ 1 μm，重复定位精度 ≤ ±3 μm。安全配置：配左右极限限位、零点光电开关、过载保护、硬件急停按钮。安装台面：光学级铝合金台面，平面度 ≤ 0.4mm/600mmx600mm，预留标准 M6 螺纹孔 ≥ 9 个，M4 螺纹孔 ≥ 20 个，适配标准光学平台安装。</p> <p>(3) 多轴精密手动位移台：左右对称配置各 1 套，固定于电动位移台台面，整体高度适配标准光学平台光路系统。平动轴 X/Y/Z：单轴行程 ≥ ±6.5mm，微调精度 ≥ 10 μm/刻度；旋转轴 θ z（绕轴旋转）：360° 全范围连续可调，精调范围为 ±10°。单台负载需 ≥ 3kg，台面需预留标准 M6、M4 通用安装孔位，可适配安装光纤夹具。</p> <p>(4) 多轴控制和显示系统：控制高精度电动位移机构，需至少具备点动和增量控制两种模式，需配备有模式控制按钮、归位按钮、前进按钮、后退按钮，还需配备显示屏和 0-9 数字按钮，可方便设定参数以及实时显示当前所施加的应变大小，配有软件操作系统。</p> <p>(5) 温控系统：配备有多个可替换温控器，温控器支持室温到 400℃ 的宽范围调控且温度调节控制精度 ≤ 0.1℃。温控系统可根据不同光纤传感器测试需求快速切换，适配不同尺寸测试光纤的温控需求。</p> <p>(6) 光纤夹具模块：左右对称配备光纤夹具，需支持光纤 360° 轴向连续旋转和锁定，旋转轴面有刻度标识，刻度精度不大于 5° / 刻度。夹具须配有 125 μm 包层直径的光纤夹具，保证夹具夹紧光纤后，在应变温度测试全行程拉伸中，光纤无滑移、无偏移、无低频晃动，保证传感光谱无光纤抖动漂移</p> <p>(7) 光纤成像模块：光纤夹持装置上方配 1 套高像素采集相机（带显微物镜），400 万像素，2 μm × 2 μm 像素单元，2688 × 1512</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----|----|---|--|--|--|--|--|
| | | <p>分辨率，支持图像输出显示、USB 输出、HDMI 高清输出（HDMT 输出 1080P；USB 输出 30@fps），可连接鼠标进行图像标注和测量，且可支持 U 盘连接进行图像保存。成像支持 1X-16X 变焦放大，配合物镜最大可放大 200 倍，支持自动/手动自平衡，对比度清晰度饱和度 10 倍可调节，配套成像显示模块。</p> <p>（8）成像模块底座：配套对应成像系统夹持器，CCD 高度上下可调 $\pm 10\text{mm}$，底座配套 X、Y 位移机构，XY 行程 $\geq \pm 25\text{mm}$，底板开 M6 孔位，使其可固定在光学平台上。</p> <p>4、光纤曲率传感器性能测试装置：</p> <p>（1）可实现待测光纤传感器样品的高精度曲率施加，曲率施加独立可控，可精准完成光纤传感器的曲率灵敏度标定。</p> <p>（2）中心下压模块：底座具备 X、Y 轴平动调节功能，行程均须 $\geq \pm 6.5\text{mm}$，以确保下压探头能够精准对准光纤的测试中心点。垂直方向上须配备有高精度位移杆，下压位移精度需 $\leq 10\ \mu\text{m}$。</p> <p>（3）多轴精密位移台：左右对称配置各 1 套，固定于测试装置台面，整体高度适配标准光学平台光路系统，即台面需与中心曲率装置实现光学同高。平动轴 X/Y/Z：单轴行程 $\geq \pm 6.5\text{mm}$，微调精度 $\leq 10\ \mu\text{m}/\text{刻度}$；旋转轴 θ_z（绕轴旋转）：360° 全范围连续可调，精调范围为 $\pm 10^\circ$。单台负载需 $\geq 3\text{kg}$，台面需预留标准 M6、M4 通用安装孔位，可适配安装光纤夹具。</p> <p>（4）光纤夹具模块：需 360° 全范围连续可调，旋转轴面有刻度标识，刻度精度小于等于 $5^\circ/\text{刻度}$。须配有 $125\ \mu\text{m}$ 包层直径的光纤夹具，保证夹具夹紧光纤后，在曲率测量全程弯曲中，光纤无滑移、无偏移、无低频晃动，保证光谱测量无抖动误差。</p> <p>（5）刚性装置底座：</p> <p>整体结构：高强度光学级实心铝合金或具有极低热膨胀系数的金属材料，长度 $\geq 200\text{mm}$，宽度适配多轴系统。</p> <p>功能要求：需将左右两侧多轴手动位移台与中心应力下压装置进行统一的刚性连接，确保所有组件水平，消除分体式摆放带来的形变误差。</p> <p>接口要求：整体平台表面须经过阳极氧化黑化处理，并规则开具若干 M6 与 M4 标准螺纹孔位，便于装置整体固定于防震光学平台上。</p> | | | | | |
| 11 | 合计 | | | | | | |

注：1. 以上报价不限品牌。功能仅供参考达到或优于以上参数即可，参与竞谈单位根据以上功能需求，提供自有品牌产品的详细技术方案，技术方案中提供详细的功能描述、技术参数（严禁完全复制竞谈文件参数），并注明详细品牌和型号。

2、以上报价包含安装设备所需的所有辅材。

五、最终报价及相关文件要求：

（一）报价文件格式

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 详细技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
|----|------|-----------------------|------|--------|----|----|-------|-------|----|
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | 合计 | 大写： (小写： ¥000,000.00) | | | | | | | |

（二）技术文件格式（投标产品参数不得复制参考参数，须提供自有产品详细参数）。

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标参考参数 | 投标产品参数 | 偏离 | 说明 | 备注 |
|----|------|-----------------------|------|--------|--------|----|----|----|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| | 合计 | 大写： (小写： ¥000,000.00) | | | | | | |

投标相关文件要求：

1. 所有报价均以人民币最终报价，含设备费用、安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费(提供增值税普通发票)、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求。

2. 竞价人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。

3. 竞价人在投标的同时请附上企业现行合法有效的营业执照原件（或营业执照公证件）及复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4. 如竞价人单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书及竞谈人在本公司购买的近6个月社保证明（谈判现场联网验证或官方渠道核验）。若除谈判代表外另有其他人员共同到场参与本次竞争性谈判，则到场人员均需在谈判现场提供在本公司近6个月的社保缴纳证明（谈判现场联网验证或官方渠道核验）。

5. ★标书中的报价文件和技术文件需分别独立封装。其中报价文件应包含详细的设备清单及报价；技术文件则必须涵盖资质证明、竞价人提供的近三年内3个以上同类产品的业绩合同复印件（需加盖单位公章）或竞价人提供的厂家近三年内3个以上同类产品的业绩合同复印件（需加盖厂家公章）。此外，技术文件还应包括谈判代表的授权书、

社保证明、详细清单、技术参数偏离表、建设方案以及售后服务方案等，且技术文件中严禁包含任何产品报价信息。投标现场还需提供一份 U 盘，存储上述资质证明、业绩合同复印件、谈判代表的授权书及社保证明等文件的盖章件电子档。

6. 对于代理产品的供应商，若中标，在签订合同前，必须提供原厂家的授权书及售后承诺书（需加盖厂家公章）。

六、交货及货款的结算方式：

在合同签订后，严格按照院方指定的时间、地点安装调试完毕，并作好人员培训等相关工作，经验收合格后支付总货款的 95 %，余款 5%在质保期满后支付。

七、谈判有关说明：

1. 谈判地点：重庆人文科技学院后勤一楼会议室。

2. 谈判时间：2026 年 6 月 29 日上午 9 时 00 分。

3. 有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，我处恕不接受。

八、联系人及联系方式：范老师 023-42460570

九、凡涉及本次谈判文件的解释权归竞争性谈判管理小组。

十、一切与谈判有关费用，均由竞价人自理。

第二部分 竞争性谈判相关附件

附件 1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款

甲方（买方）：重庆人文科技学院有限责任公司

乙方（卖方）：

甲乙双方就甲方向乙方购买_____事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：

（注：以下内容为买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格

（二）合同总价格为（大写）：_____（小写：¥000,000.00），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为____年__月__日起至____年__月__日止。

三、交货时间

甲乙双方签定合同后，乙方须在____年__月__日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的 20%向甲方承担违约金。

六、付款方式

（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的95%，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。

（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税**普通**发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。

七、售后服务

1、所有物品自验收合格之日起____年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在 2 小时内作出售后服务承诺，并在 24 小时内上门服务。

（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）

附件 2：谈判申请及声明

致：_____（竞争性谈判人）

根据贵方项目编号_____的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本叁份。

据此函，签字人兹同意如下：

1. 我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

2. 一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3. 我方指派_____（姓名）（身份证号码：_____）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。

4. 我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已缴纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5. 与本申请有关的正式通讯地址为：

地 址：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日 期：_____年____月____日

